



東京エレクトロン デバイス株式会社

東証一部 [証券コード：2760]

東証IRフェスタ2012会社説明会 エレクトロニクス商社の役割と成長戦略



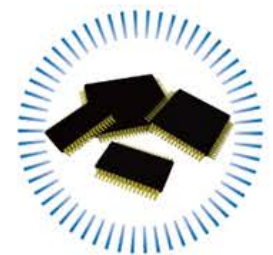
目次

会社紹介

経営ビジョン・トピックス

成長戦略

身近な場所に半導体



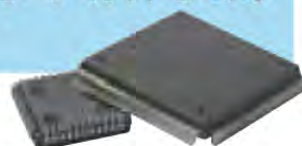
東京エレクトロンデバイス株式会社

代表取締役社長 栗木康幸

当社のあゆみ

1965年 東京エレクトロン(株)にて、
電子部品ビジネスを開始

1998年 東京エレクトロンの
電子部品事業(現:半導体事業)
が分離・独立



2003年 東京証券取引所
市場第二部上場

2006年 東京エレクトロンの
コンピュータシステム事業を
承継



2010年 東京証券取引所
市場第一部上場

東京エレクトロングループでの役割

製造装置メーカー

東京エレクトロン



専門商社

東京エレクトロンデバイス

半導体事業



1998年事業独立

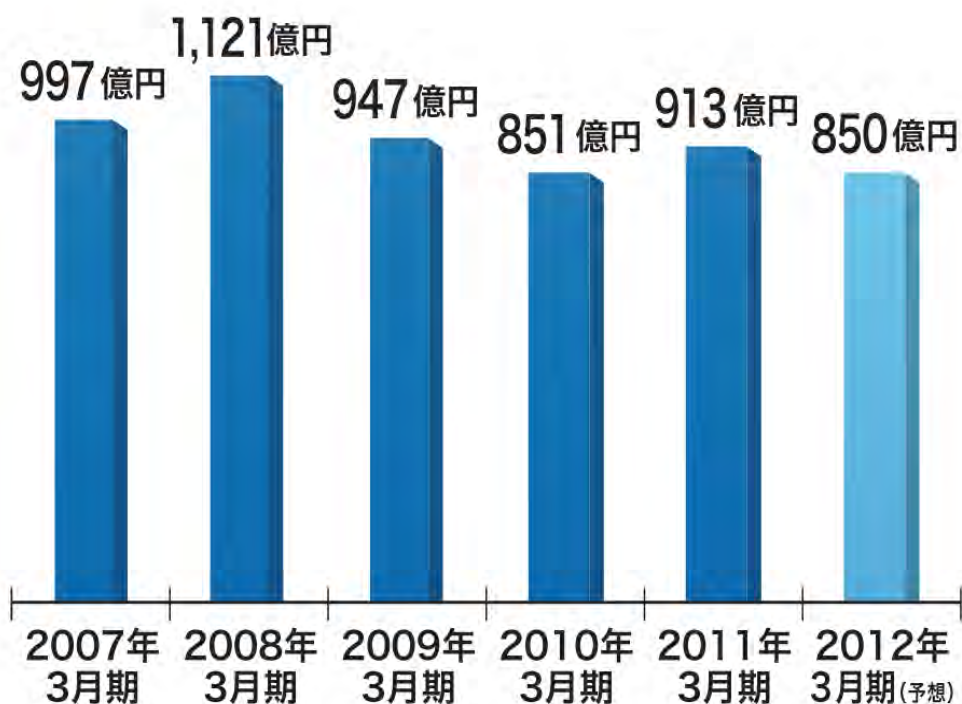
コンピュータ システム事業



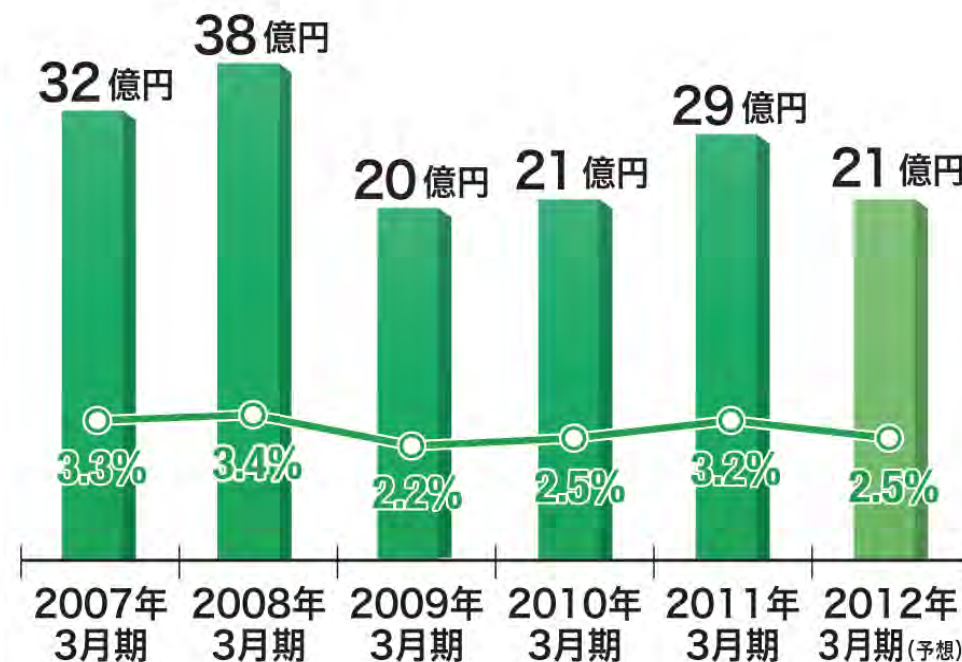
2006年事業承継

業績推移

■ 売上高



■ 経常利益 -○- 経常利益率



売上構成比
80%

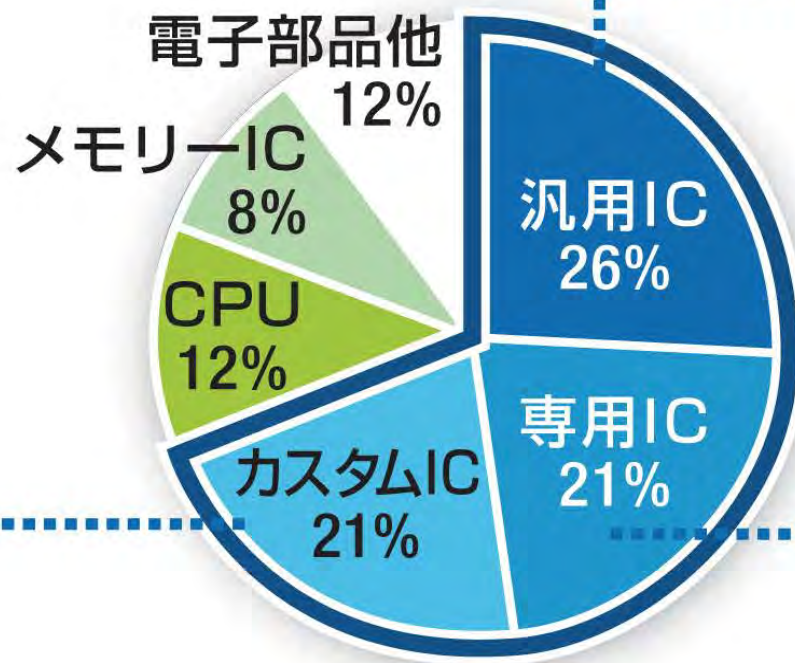
半導体事業

■ 付加価値の高い半導体を中心にラインアップ



主な仕入れ先

- ・ ザイリンクス
- ・ 富士通



2011年3月期実績



主な仕入れ先

- ・ リニアテクノロジー
- ・ TI



主な仕入れ先

- ・ フリースケール
- ・ ピクセルワークス
- ・ ビクシスシステムズ
- ・ シリコンイメージ
- ・ TI

※仕入れ先の社名は略称で記載しております。



東京エレクトロン デバイス株式会社

売上構成比
80%

半導体事業

■ 幅広い用途で活用されています

産業機器

37%



通信機器

22%



民生機器

21%



PC&周辺機器

15%



車載機器

5%

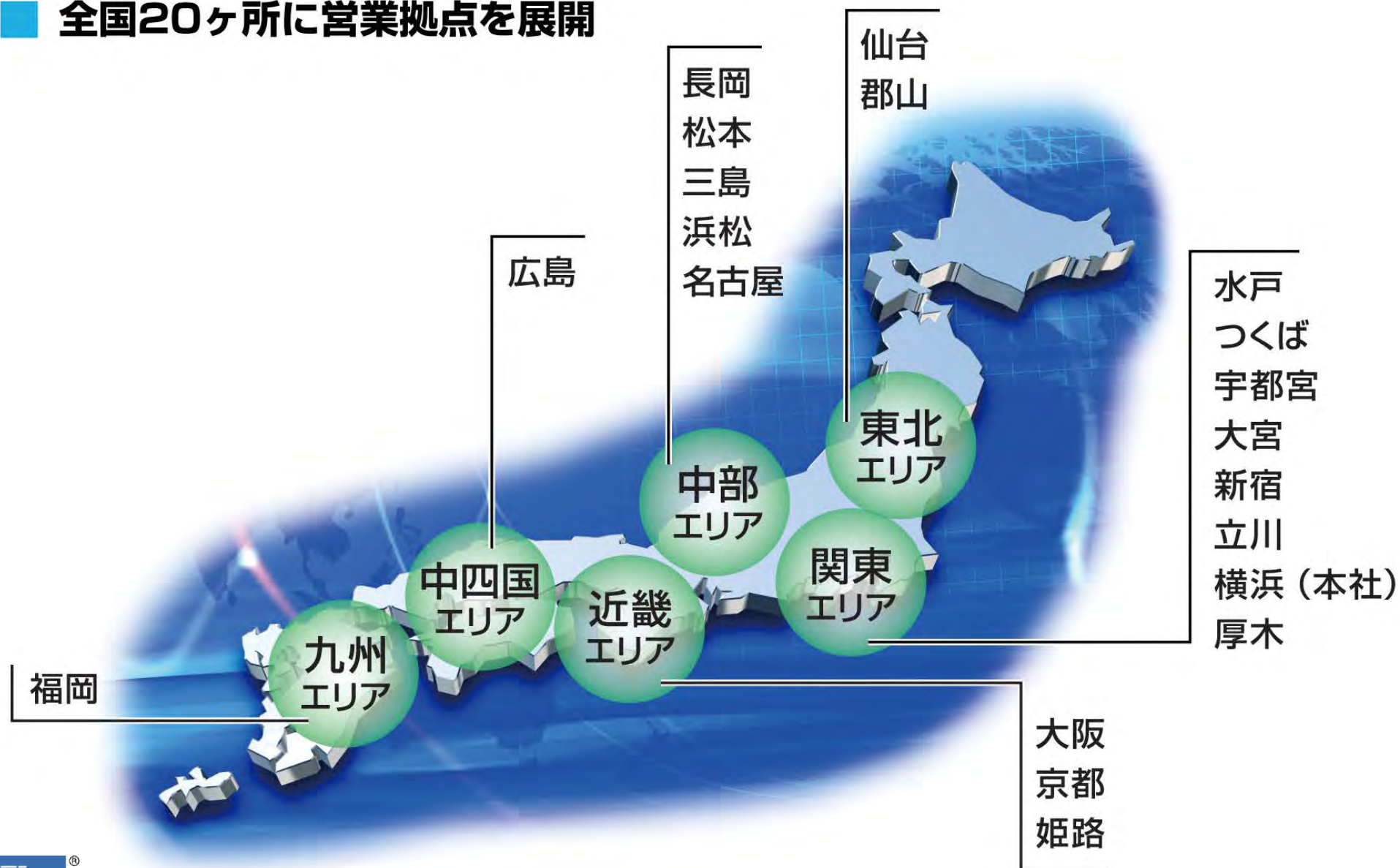


2011年3月期実績

売上構成比
80%

半導体事業

■ 全国20ヶ所に営業拠点を展開



売上構成比
20%

コンピュータシステム事業

お客様にとって最適なIT環境を提案します

製品販売



システム構築



保守サポート



注力するビジネス

開発ビジネス

技術力を生かして設計・開発を行う

＜インレビウム＞
inrevium

設計受託 デザインサービス 量産受託 OEM

お客様の依頼で
設計・量産を
手掛ける



主なお客様 エレクトロニクスメーカー

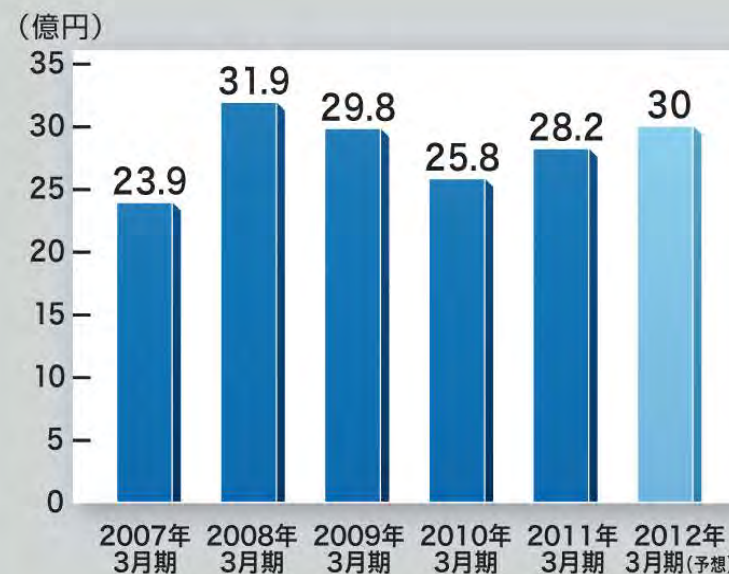


自社ブランド商品

市場ニーズから商品を開発して販売

監視カメラなどに搭載
される画像処理用IC

ザイリンクス社FPGAを
搭載したLSI開発用評価
ボード

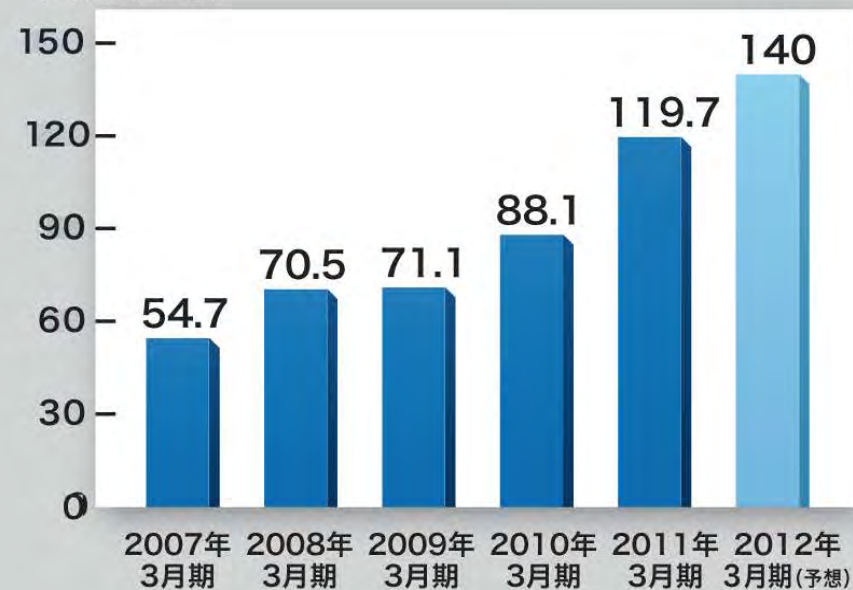


注力するビジネス

海外ビジネス 成長著しいアジア地域向けに半導体を販売

■海外連結子会社売上高

(百万米ドル)



注力するビジネス

新ビジネス 環境・省エネルギー分野の新商材を扱う

新商材1



二次電池(リチウム電池)

- 極薄(厚さ0.17mm)
- 長寿命(充電・放電1万回、電化保持10年)
- クリーンエネルギー(有害物質不使用)

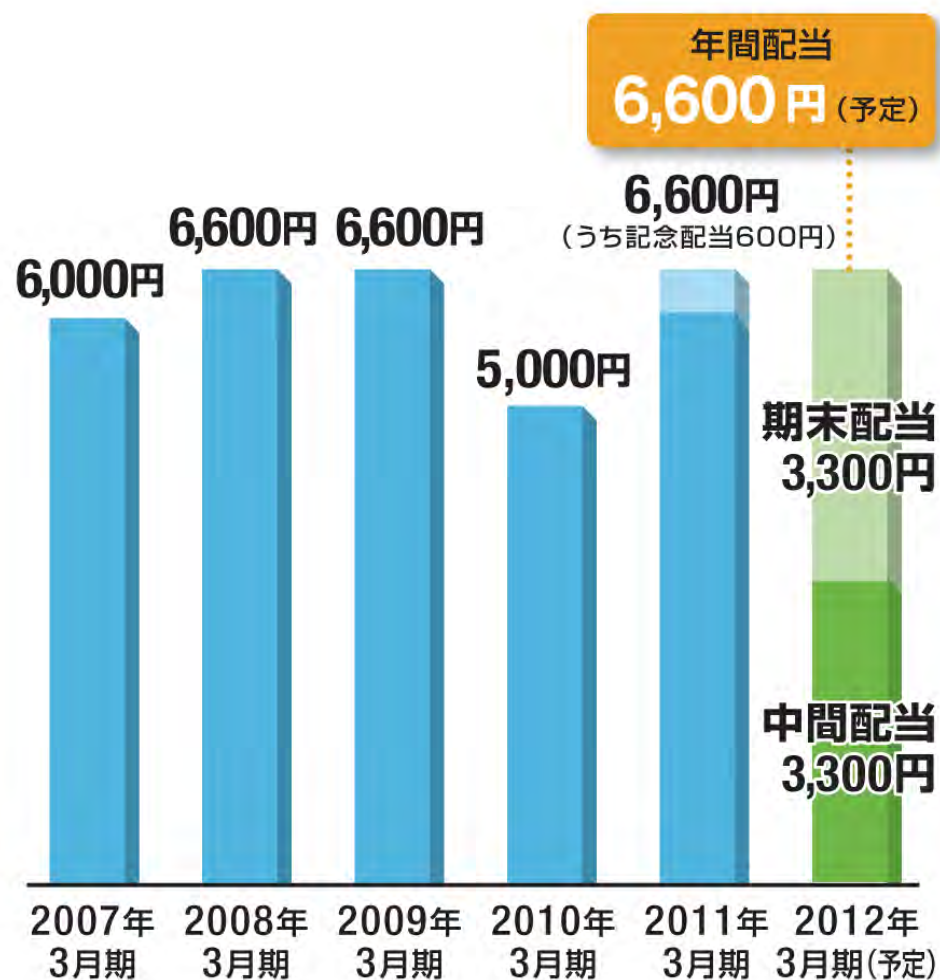
新商材2



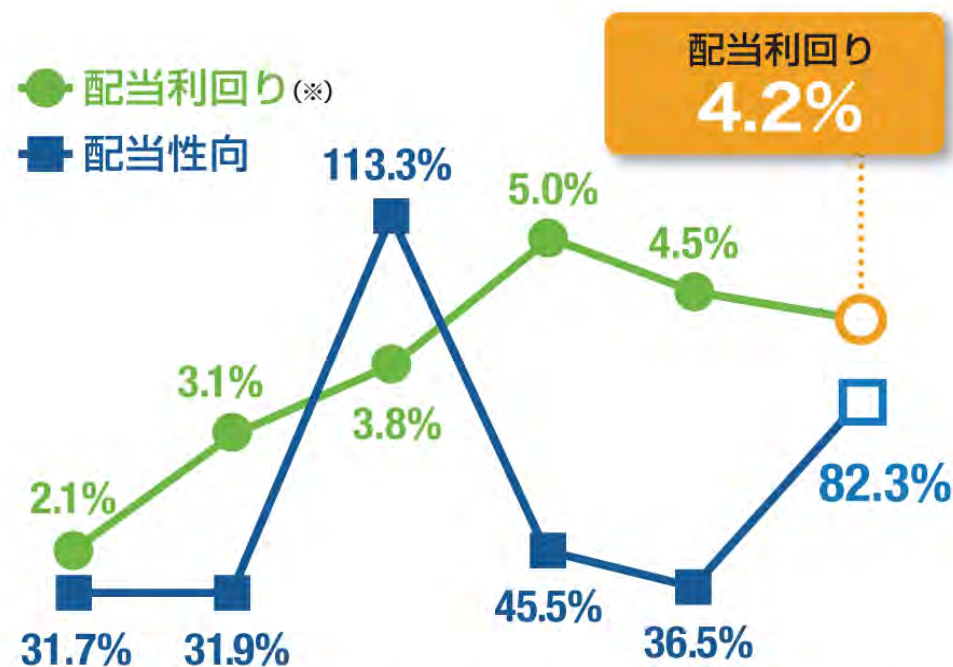
ワイヤレス発電デバイス

- 電波を使つての給電
- 発電可能な電波の帯域、感度を向上

配当金実績



配当利回りと配当性向



(※) 配当利回り = 1株当たり配当金 ÷ 期首株価終値

株価推移



経営ビジョン、トピックス

経営ビジョン

1. お客様、仕入先から絶対的な信頼を得るNo.1技術商社を目指す
2. 企業倫理の徹底
3. 次世代を担う商材と人材の創出
4. 海外事業の促進
5. 新事業への継続的な投資、投入

利益を出し続け拡大していく

株主様への還元

社員の幸福

社会への貢献

お客様の信頼

トピックス-1

◆ 新商材

日 付	メーカー名	内 容
2012年 2月	Realtek社 (半導体)	PC、プリンタなどのネットワーク向けIC
2012年 1月	Micropelt社 (新事業)	温度差発電型環境発電
2011年 7月	Powercast社 (新事業)	電波から環境発電
2011年 7月	Nicira Networks社 (コンピュータシステム)	ネットワーク仮想化ソフトウェア
2011年 1月	Fusion-io社 (コンピュータシステム)	ストレージ製品
2010年12月	Memsic社 (半導体)	MEMSセンサ
2010年10月	Semikron社 (半導体)	パワー半導体

◆ レスキューロボットコンテストに特別協賛

「技術を学び人と語らい災害に強い世の中をつくる」
というレスキューロボットコンテストの理念に賛同
CSR(企業の社会的責任)の一環として特別協賛



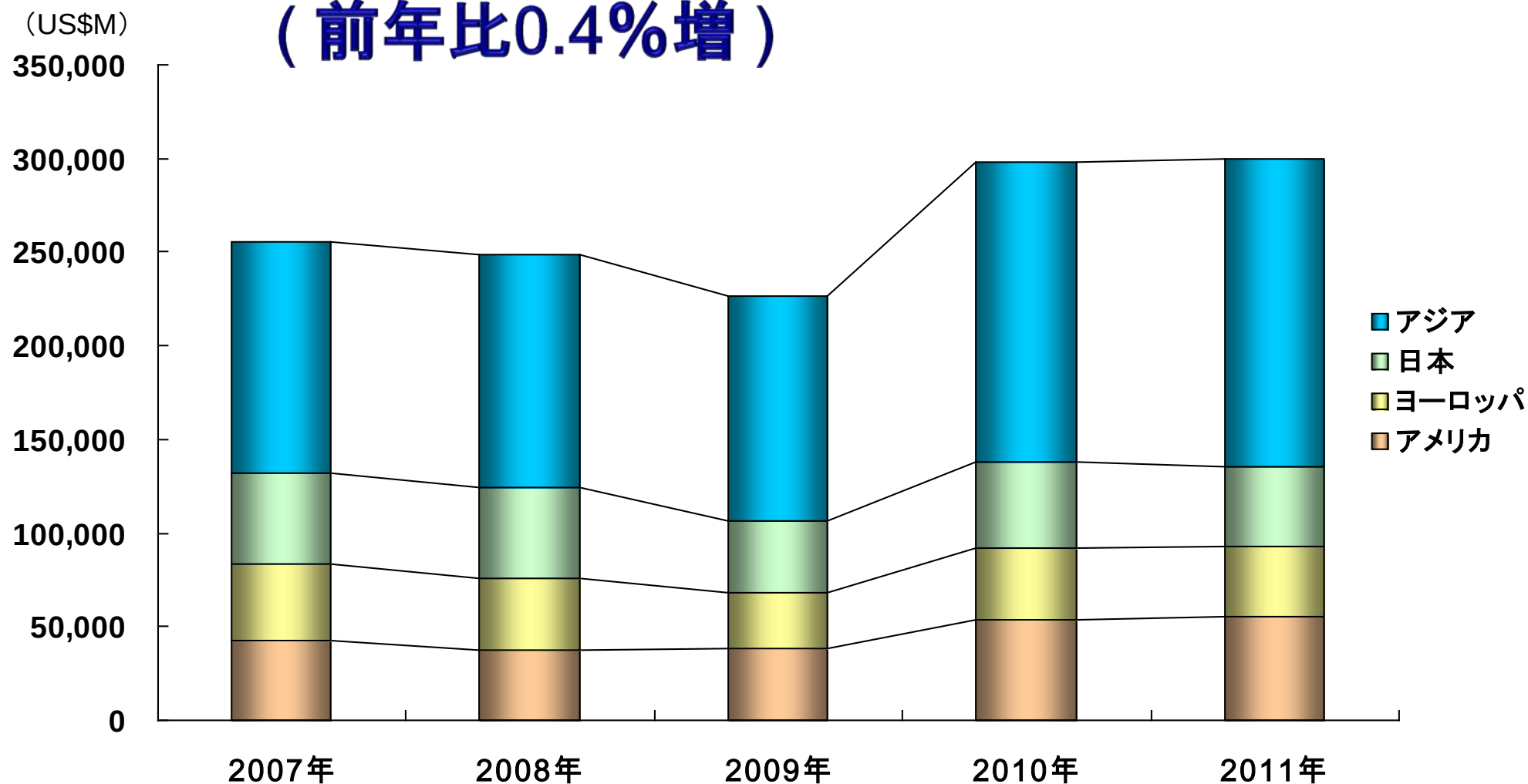
第12回 競技会

2012年8月11日(土)、12日(日)
神戸サンボーホールにて開催予定

成長戦略

1. 海外事業
2. 新事業
3. 営業戦略

◆ 2011年世界半導体出荷金額:2,995億ドル (前年比0.4%増)



出典)WSTS

1. 海外事業

◆ 海外売上高比率 半導体事業の30%を目指す

第3ステージ

inrevium

- TED香港をTEDAPACに社名変更
- アジア組織体制を強化
- 自社ブランド商品の海外展開加速
- OEM企業、ODM企業へ販売促進
- 海外現地企業への営業強化

第2ステージ

- アジア地域の拠点を拡充し移管ビジネスを拡大
- 海外現地企業へ自社ブランド商品を販売

第1ステージ

- 有望マーケットであるアジア地域に進出(香港)
- 日系企業に半導体を販売(移管ビジネス)

1. 海外事業

◆アジア地域に6営業拠点：37名（現地採用30名）

◆上海、無錫に設計開発拠点：63名（全員現地採用）

〔海外拠点〕



〔海外連結子会社売上高〕



2. 新事業

- ◆ マーケティング強化(常に新しいもの)
- ◆ 環境・省エネルギー関連製品の拡充

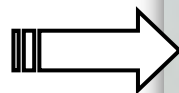
エネルギーハーベスト(環境発電)関連新商材に注力

[環境発電デバイス]

[高性能リチウム電池]



電波



電波からの発電が可能

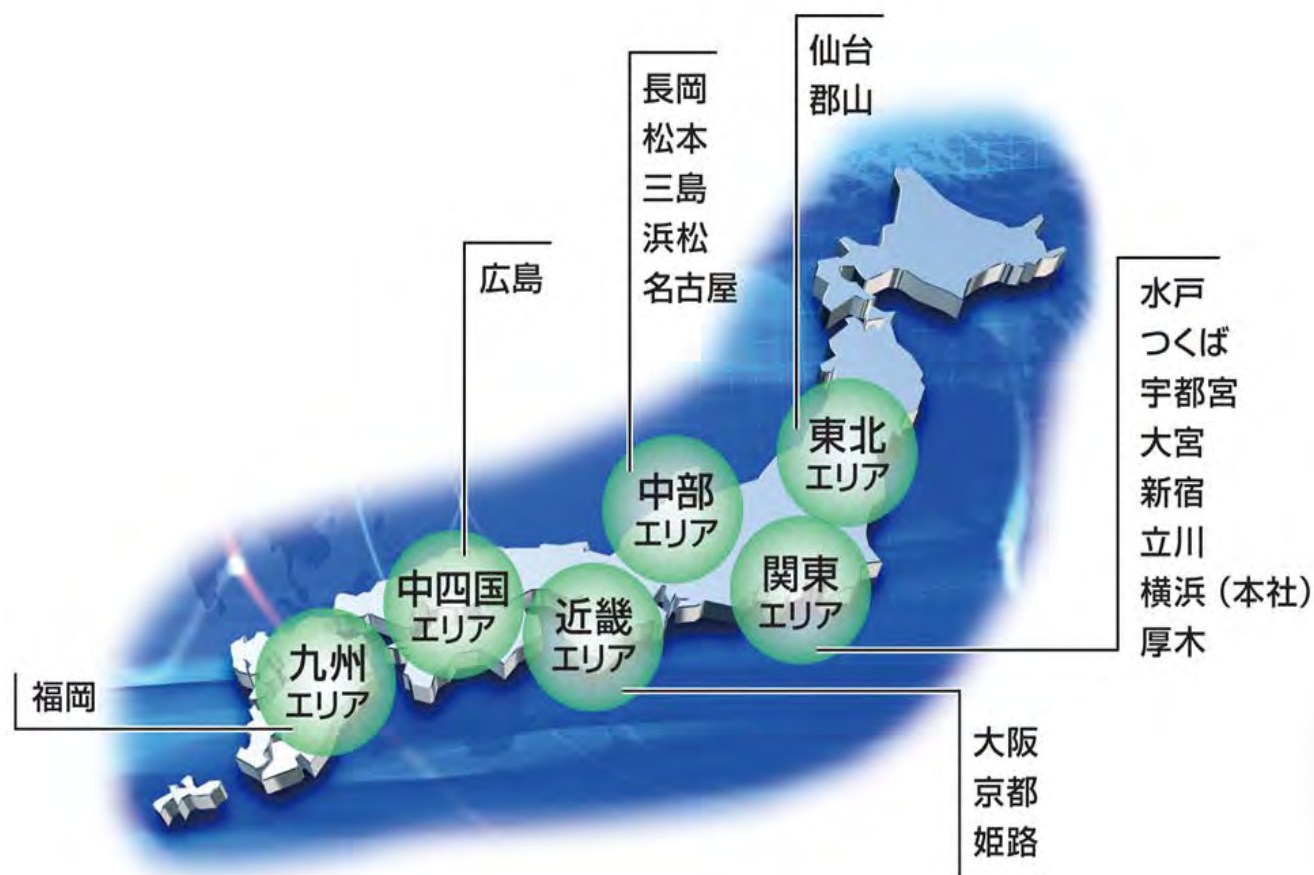
発電



発電した電力を蓄電

3. 営業戦略－1

- ◆ 地域密着営業の一層の推進
- ◆ 産業機器分野のお客様への営業強化



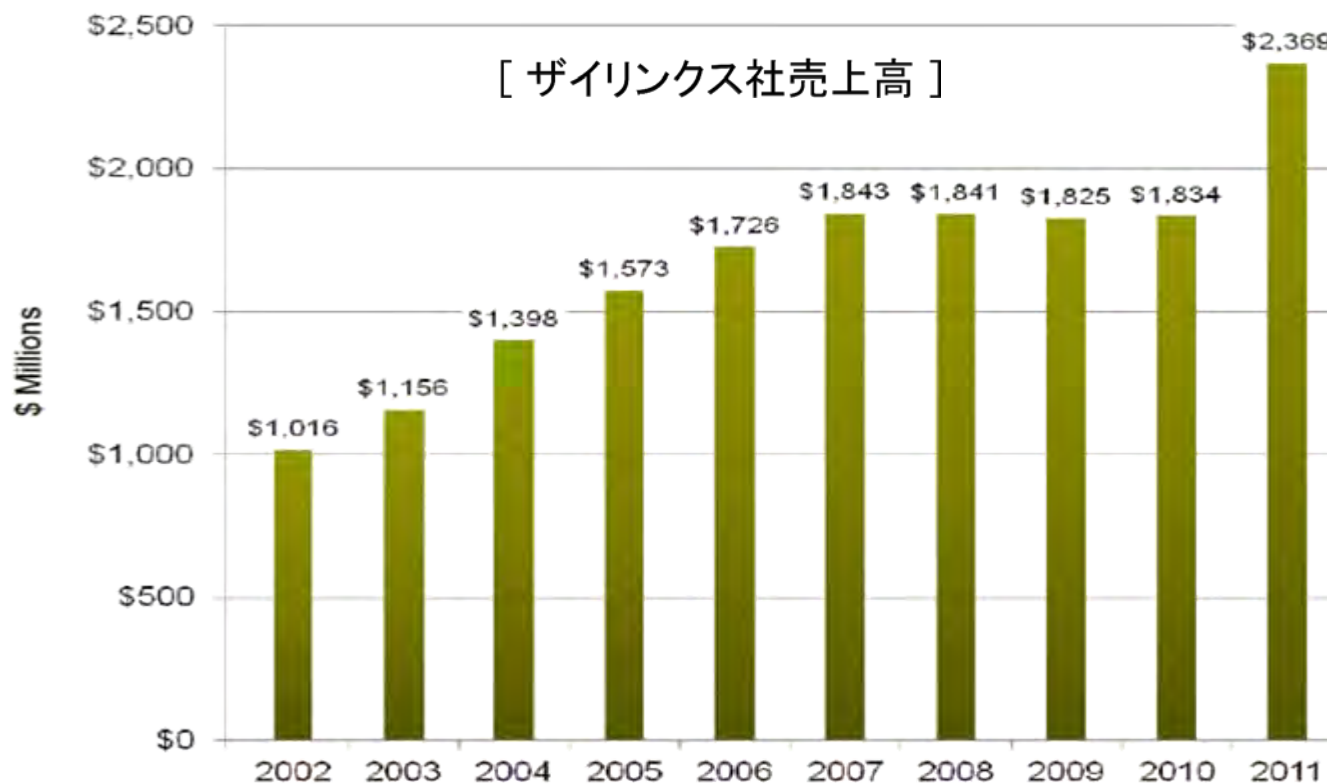
産業機器



3. 営業戦略－2

◆ 技術サポートの拡充

一例 ザイリンクス社は、FPGA(半導体の種類名称)の世界No.1企業
弊社は、ザイリンクス社が認定したプレミアメンバーの1社
世界で7社が認定され、国内では弊社1社



ビジネスプロセス、
技術的能力、製品品質、
サポート能力でザイリンクス社
が行う320項目の現場チェック
に合格している企業



◆ 自社ブランド「inrevium」の開発・販売強化

映像機器用LSI



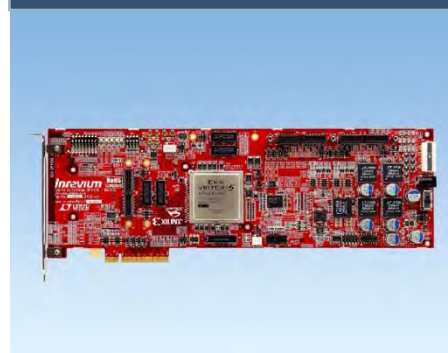
メモリコントローラ用LSI



PLD用LSI



PLD評価ボード



信号処理ボード



3次元計測ボード



3. 営業戦略－4

◆クラウド、データセンター向け新製品の投入と発掘

一例 Fusion-io社

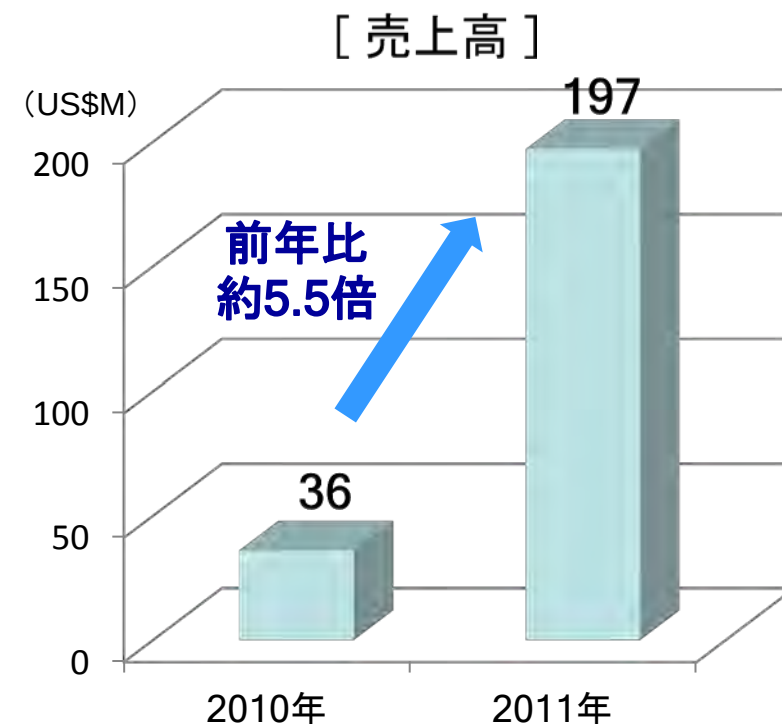
データセンターの処理能力を高める
次世代ストレージメモリプラットフォームを開発
米ウォール・ストリート・ジャーナルの
2010年度「新鋭IT企業No.1」を獲得



[会社概要]

- ・本 社：米国ユタ州ソルトレイク市
- ・設 立：2005年
- ・最高経営責任者：デイビッド・フリン
- ・従業員数：440人
- ・ニューヨーク証券取引所上場：2011年6月

(Fusion-io社 ホームページから抜粋)



広く社会から信頼される
No.1技術商社を目指してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
本日はご清聴ありがとうございました。

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

	2007/3期	2008/3期	2009/3期	2010/3期	2011/3期
ROE	10.7%	10.5%	2.9%	5.4%	8.5%
自己資本比率	42.9%	42.0%	52.6%	48.0%	46.2%
EPS	18,957円	20,689円	5,824円	11,000円	18,095円
PER	11.1倍	8.5倍	17.2倍	13.4倍	8.8倍
PBR	1.1倍	0.9倍	0.5倍	0.7倍	0.7倍
従業員数	739名	788名	825名	844名	880名

注) PER、PBRは、各年度末の株価終値を使用し算出しています。

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体事業	汎用I C	リニアテクノロジー社、TI 社
	専用I C	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメージ社、ピクシスシステムズ社、 サーリンク・セミコンダクター社、インビーム
	カスタムI C	富士通セミコンダクター(株)、ザイリンクス社、インビーム
	メモリーI C	IDT社、ラムترونインターナショナル社、スパンション社
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	電子部品他	コーセル(株)、オン・セミコンダクター社、インビーム
コンピュータシステム事業	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセージ社
	ストレージ関連	ブロード社、エミュレックス社

品 目	主な取扱商品	機 能
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるI C
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用I C
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有I C
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
電子部品他	整流素子、トランジスタ、 ボード、電源、コネクタ	増幅、整流などの機能を持つ部品 プリント配線基板上にI C、電源、コネクタなどの 部 品を実装した製品(ボード)

ネットワーク関連 	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。
ソフトウェア 	セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。
ストレージ関連 	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。